

华润微电子有限公司
投资者关系活动记录表

(2021年09月)

证券简称: 华润微

证券代码: 688396

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 (请文字说明其他活动内容)
参与单位名称	<u>09月09日 13:30-14:30 (电话会议)</u> 国泰君安证券 南方基金 九泰基金 广发资管 天弘基金 信诚基金 招商基金 德邦基金 海通自营 国华保险资管 <u>09月22日 10:00-11:00</u> 信达证券 广发证券 永赢基金 交银施罗德 华夏未来资产 明河投资 安信基金

	南方基金 华泰柏瑞 上银基金 韶夏资本 <u>09月22日 13:30-14:30</u> 中泰证券 朱雀基金 华美国际 云杉资本
时间	09月09日 13:30-14:30; 09月22日 10:00-11:00、13:30-14:30
地点	华润微电子总部会议室
上市公司接待人员姓名	吴国屹 华润微电子财务总监兼董事会秘书
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：公司对未来行业景气度的看法？ 公司目前在手订单饱满，公司聚焦的应用领域仍供不应求，对今年下半年保持谨慎乐观的态度。</p> <p>问题二：公司未投料的订单周期和客户的交期有无变化？ 公司整体接单情况保持稳定，订单周期和客户的交期与今年上半年相比均未发生显著变化。</p> <p>问题三：公司认为目前客户的库存处在什么水位？ 公司目前客户的库存水位处在正常水平。</p> <p>问题四：公司今年下半年是否会进行价格调整？ 公司会密切关注市场变化情况，并采取对应的价格策略。</p> <p>问题五：公司现有产能扩充的情况？ 公司在有序扩充现有8吋产能的同时，也在积</p>

极开展 12 吋线的产能建设。

问题六：公司购买设备的交期是否有延长？

受新冠肺炎和半导体市场需求高涨等叠加因素影响，目前市场上晶圆设备交期普遍延长，公司购买设备的交期也长于预期。

问题七：近期一些限电的政策是否对公司生产造成影响？

公司的供电受到保障，暂未对生产造成影响。

问题八：公司未来 5 年的业务长期规划发展？

公司将保持战略定力，立足现有基础，进一步聚焦于功率半导体、智能传感器和智能控制等广泛应用于新经济领域的半导体产品，通过技术创新保持在业内的领先优势，同时深耕国产替代的中国市场机会，不断推出适应市场需求的新技术、新产品，保持、巩固并提升公司现有的市场地位和竞争优势。

问题九：公司未来对 IGBT 的定位和规划？

未来公司 IGBT 产品制造工艺技术全面提升至 8 吋，通过 8 吋 IGBT 技术平台开发和产品系列化研发，进一步提升产品性能与可靠性，通过 IGBT 芯片模块化，进行价值延伸和扩展客户选型空间。

问题十：公司 MOSFET 业务的规划？

公司 MOSFET 产品以高端应用需求为导向，通过特色工艺能力建设，未来将持续加快平台技术迭代与丰富产品系列，全面提升公司产品应用能力，进一步巩固并扩大产品领先地位。

问题十一：公司第三代化合物半导体业务的进展？

公司自主研发的第一代 650V、1200V SiC JBS 产品实现量产，并实现销售突破；自主研发的新一代 650V SiC JBS 产品实现技术突破，综合性能达到业界先进水平；平面型 1200V SiC MOSFET 产出工程样品，静态技术参数达到国外对标样品水平，正在进行可靠性优化。

自主研发的第一代 650V 硅基氮化镓 Cascode 器件样品静态参数达到国外对标水平，正在进行外延材料质量、芯片面积及工艺的优化，以进一步提升器件可靠性和性价比；自主研发的第一代 650V 硅基氮化镓 E-mode 器件实现器件功能，工艺开发中。

问题十二：公司认为 SiC 市场何时可以实现大规模起量？

公司认为 SiC 器件在某些领域拥有硅器件无法达到的性能优势，但是受限于目前 SiC 衬底等材料的高昂成本，短期内无法快速起量。未来随着 SiC 材料价格的进一步下降，SiC 产品销售有望实现迅速突破。

问题十三：公司 BCD 工艺主要用于生产哪些产品？

公司 BCD 工艺主要用于生产电源管理类产品，其中低功耗类表现较为出色。

问题十四：公司车规级业务的进展？

公司未来在汽车电子方面将重点布局第三代化合物半导体和 MOSFET，参照车业项目流程，公司加快中低压 MOS 产品的研发，并积极与国际一流大厂和整车厂对接交流。

问题十五：公司在外延方面的进展？

公司未来外延的方向将重点围绕功率半导体

	<p>和智能传感器相关领域。公司会持续开展外延工作，助推公司实现跨越式发展。</p> <p>问题十六：公司成本端是否有价格增长？ 公司目前成本端价格整体保持稳定。</p> <p>问题十七：公司有哪些与人才相关的激励措施？ 公司对于人才采取了多种激励措施：实施市场化的薪酬体系；建立项目跟投、研发项目激励。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021年09月